# 19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A) 昭57—173819

Mnt. Cl.3

G 02 F 1/31 5/174 1G 02 B G 02 F 1/03

識別記号

庁内整理番号 7529-2H 8106-2H 7529-2H

砂公開 昭和57年(1982)10月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

30光スイッチ

20特

願 昭56-60195

2)出

4

願 昭56(1981) 4月20日

分発 明 者 川口隆夫

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

②発 明 者 黄地謙三

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

切発 明 者 三露常男

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑫発 明 者 和佐清孝

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

の出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

1、発明の名称

光スイッチ 2、 特許請求の範囲

(1) 基板の表面を被膜で覆い、この被膜に互いに 交差する壽を設けかつこの壽に光伝搬媒体を埋設 することにより互いに交差する光導波路を形成し、 剪記光導波路の交差部上にプラッグ回折を行なう プラッグ格子を設け、このプラッグ格子の近傍に 1 対の電弧を設けたことを特徴とする光スイッチ。

- (2) 光伝教媒体の光の屈折率が、被膜および基板 の表面部の光の屈折率より大きいことを特象とす る特許請求の範囲第1項記載の光スイッチ。
- 3) 基板の表面が、MgO,a-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(サファイ ヤ),スピネル、SrTiOgのうちの少なくとも 一種で構成され、かつ光伝搬媒体が、 BaTiO3, PbTiO3, PLZT系化合物の少なくとも一種で構 式されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項 乞載の光スイッチ。
- (4) 基板の表面をBGO(Bi<sub>12</sub>GeO<sub>20</sub>)で構成

し、かつ光伝搬媒体をBTO(Bi<sub>12</sub>TiO<sub>20</sub>)あ るいは、BSO(Bi, 2SiO20)で構成したこと を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光スイ

- (5) 基板の表面をLiTaO3で構成し、かつ光伝搬 媒体をLiNbOgで構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光スイッチ。
- (6) 基板の表面をGaPで構成し、かつ光伝搬媒体 をGaAsで構成したことを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の光スイッチ。
- (7) 基板の表面を a Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>で構成し、かつ光 伝搬媒体をZnO, ZnS, CdS, ZnSe, ZnTe あるいはこれらの化合物のうち一種で構成したこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光ス イッチ。
- (8) プラッグ格子を少なくとも光伝搬媒体に周期 的に凹凸を設けて形成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光スイッチ。
- (9) プラッグ格子が少なくとも光伝搬媒体上にこ の光伝搬媒体の屈折率より小なる屈折率を有する

材料に周期的に凹凸を設けたプラック格子形成膜 からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の光スイッチ。

00 プラッグ格子形成膜が透明導電膜からなることを特徴とする特許請求の範囲第9項記載の光スイッチ。

プラッグ格子が透明導電膜からなり簡形電極を構成することを特徴とする特許請求の範囲第9項記載のダイッチ。

03 プラッグ格子上にこのプラッグ格子の光の屈 折率よりも小さい光の屈折率を有する材料からなるパッファ層を設け、このパッファ層上に太陽電 他を積層させ、この太陽電池と1対の電極とを電 気的に接続したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の光スイッチ。

#### 4、発明の詳細な説明

本発明は、光スイッチに関するものであり、特に光IC用の薄膜光スイッチを提供するものである。

電子回路で電気を導くのに導線を使用するよう

5

本発明は、これらの光スイッチの構造とその構成材料に改良を加え、従来の光スイッチの欠点を除去するものである。

すなわち、本発明の目的は、小型光デバイスあるいは光ICに用いるのに適した光スイッチの構造とその構成材料を与えることである。

以下、図面を用いた実施例により、本発明を説明する。

第2図は本発明の一実施例にかかる光スイッチ である。

すなわち本実施例の光スイッチ21は、少なくとも表面221を保護被膜231で優われた基板22と、保護被膜231に設けてU字溝232と、U字溝232内に埋没された光云紫媒体233とからなる光導放路23を用いて交差する該光導放路23を用いて交差が多いで変差が多いです。該光導放路23の交差部24上の両光導放路間でプラック条子25に近接による。 が交差がでプラック格子25に近接した少なくとも2つの電圧的加電板26とが形成される。 に、またマイクロ波回路では導波管を使用する。 うに、光信号処理システムあるいは光ICでは 各種の光導波路が必要になる。

小形化光デバイスあるいは光ICに用いる光スイッチは従来例えば第1図(a),(b)に示すような、リッジ型(a)あるいは拡散型の導放路(b)を用いて形成していた。この場合、リッジ型では、例えば石英ガラスからなる基板11の上に、硼珪酸ガラスからなる薄層12を設ける。また拡散型では、例えば、LiNbO3単結晶基板13の表面に、Tiの拡散層からなる導放路14を設ける。

この種の光導波路は光の伝達のみならず、各種 光回路,例えば光スイッチの形成のあるいはこれから を集積化した光ICの形成に用いられる。しか ながら、リッシ型は、表面に凹凸があるから、欠な の上に例えば光スイッチを形成し難いというの がある。また、拡散型光導波路の例では、導攻 の境界が不明確であり、例えば可一表面に二次 ので複数のスイッチを集積化する場合、集積度に 限界があるという欠点がある。

この場合、光が光伝搬媒体23のみを通過すべく、光伝搬媒体23における光の屈折率を、保護被膜なよび基板22の表面層の光の屈折率より大きくする。

第2図に示すごとく、本発明の実施例にかかる 光スイッチは、その表面が平坦である光導波路を 用いている。また、光導波路部のU字溝の形成と、 光伝搬媒体のU字溝への埋込みは、通常の半導体 プロセス例えば蒸着プロセスとホトリンプロセス で形成できるから、従来の拡散型に見られるよう な光導波部の面内での広がりが少なく、第2図の U字溝232の境界に示すような、シャープな光 漢波路境界が実現できる。このため、本発明の実 施例にかかる光スイッチは、光デバイスの高密度 化、IC化に有効となる。

本発明者らは、この種の光スイッチの形成に、 最適の構成材料があることを見い出し、それに基 づき、高性能の小型薄膜光スイッチを発明した。

すなわち、第2図の光スイッチの構造において、 某板を MgO, a— Ale<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(サファイヤ)、スピネル,

蒦

τ

à

ź

Ė.

玄

ス

ĵ

C.

4

耋

줗

푳

۲,

 $SrTiO_3$  のうちのいずれかで構成し、該光伝搬棋 体を、BaTiOg , PbTiOg あるいはPLZT系化 合物のうちのいずれかで構成すると、形成も容易 z でかつこの種の光スイッチの集積化も容易である ととを見い出した。すなわち、第2図の構造の光 귛 スイッチにおいて、光伝搬媒体中の光の屈折率が、 ũ 表面保護層および基板中の光の屈折率より大きい ス という基本的な条件以外に、光スイッチとして実 9 用するには、例えば光伝搬媒体中の光の伝搬損失 D が小さいこと、また光伝搬媒体が形成され得るよ りな特性をもった基板を有することが重要である。 獲 さらに、この種の光スイッチが、小型化あるいは ີວ 集積化光デバイスにも応用されるには、光伝搬媒 し 体が例えば大きい電気光学効果を示す必要がある。 ح さらに、表面保護層の形成と、U字溝への光伝搬 赤 媒体の埋込みが可能であることも、これらの材料 嵜 の選択に重要である。 元 ĸ

光伝搬損失が小さく、しかも電気光学効果が大きい材料としては、従来の技術では、例えば、 LiNbO3 のバルク単結晶があるが、第2図の構造

能する。さらに前記プラック格子はまた前記光伝 厳媒体上に前記光伝搬媒体の屈折率より小さい屈 折率を有する材料で周期的に凹凸を設けてプラッ ク格子が形成される。

本発明の光スイッチの構成とその実現の可能性について、構成材料を変えて探索した結果、例えば、光伝搬媒体として、PbTiO3 薄膜が適し、基板にサファイヤ(αーA62O3)単結晶板が適し、電圧印加電極に例えば蒸着A8が適していることを確認した。すなわち、この種の構成材料では、スパッタリング法かよび真空蒸着法という薄膜形成技術を発明にかかまなとにより、比較的低温で、本発明にかかるととを確認した。

次に本発明にかかる光スイッチの形式手順と構 成材料要素をさらにくわしく説明する。

まず、例えばサファイヤ(OOO1)面の単結晶板を基板にし、この上に、例えば石英ガラス膜を厚さO.2 μ m 程度例えば高周波スパッタリングで展

を実現するためには、この種のバルク単結晶を薄く研磨して、LiNbO3より光の屈折率が小型がある。例えば、石英ガラス板上に接着する必要がある。一方、高度の光通信には単一モー厚さるの光流のでは、光伝散集体の厚さる。と同程度の μmオータに研磨 満には、単結晶を μmオータに研磨 満には、単結晶を μmオータに研磨 満には、単結晶を μmオータに研磨 満には、のとは LiNbO3 光伝搬路の場合は、 程程の サ光の屈折率が小さして形成する。 したが 明の高温下で液相エピロセスでは、第2回ような製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回よりな製造プロセスでは、第2回にかかる光導波路は実現できない。

第2図に示すように本発明の実施例の光スイッチにおいて、プラック格子を少なくとも光伝搬媒体に周期的な凹凸を設けて形成すると、形成が容易でかつ集積化も容易であることを発見した。また、前記プラッグ格子のプラッグ条件を満足するのは光の単一モードのみであるため、多モードの光を用いる場合は光のモードフィルターとして機

10

着する。この場合、蒸着時の基板の温度は、200~300℃程度である。この石英ガラスに関よりなる被膜に通常の半導体製造プロセスに用いる例えば、オトリソ加工により、U字響を形成する。なに、このU字溝部に、再び高周波スパッタリングで、PbTiO3 薄膜を、石英ガラスの厚さだけ蒸着する。この場合、基板温度を600℃程度にし、化学組成がPbTiO3 の化学当量比からのずれがないとすると、(1 1 1)面のPbTiO3 の透明な単結晶薄膜が形成される。

このよりに形成された光導波路の交差部をたと えばフォトリソ加工によりプラッグ条件を満足す る周期的を凹凸を設けプラッグ格子を形成する。 次に例えば A8 をO.2 μ m 真空蒸着したのちフォ トリソ加工により電圧印加電極を例えば第2 図の とくプラッグ格子に近接し該プラッグ格子をは さみこむ配置とし、前記電圧印加電極を直流電源 に接続する。

簡単のため単一モードの光で説明すると電源 OFFの場合、光導波路内を伝搬してきた光は

-109-

11

プラック格子間隔が 7.6 μm , 前記電圧印加電 を間距離が 8 0 μm , 波長が 0.63 28 μ m の光 波の場合、印加電圧が 9 0 V で 1 0 d B の消光比 を得ることを確認した。 従来の Ti 拡散型光導波 路を用いて上配と同様の構成で光スイッチを作製 する場合、光導波路の広がりの影響のため消光比 5 d B であったのと比較して、前配実施例の場合 非常に改善されていることが確認できる。

以上の説明では、基板としてサファイヤ(0001)

面単結晶板について述べたが、同様な効果は、MgO , SrTiO<sub>3</sub> 単結晶の(1 0 0)面や、スピネル (MgO - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) 単結晶の(1 1 0)面を基板に用いても得られることを確認した。この場合は、PbTiO<sub>3</sub> 膜な(1 0 0)面が成長する。

さらに、光伝搬媒体も、PbTiO3以外に、BaTiO3中PLZT系薄膜例えば、PLZT(タ/85/35)、PLT、PZTなどのペロプスカイト構造の薄膜でも、PbTiO3と同様の製造プロセスで形成でき電気光学効果も大きく、本発明にかかる光スイッチの構成材料として有効である。

(以下余白)

13

さらに同様の構成材料として、基板として、 BGO(Bi<sub>12</sub>GeO<sub>2O</sub>)単結晶を用い、光伝搬媒体としてBTO(Bi<sub>12</sub>TiO<sub>2O</sub>)あるいはBSO(Bi<sub>12</sub>SiO<sub>2O</sub>)薄膜を用いることが可能であることを確認した。さらに基板材料としてLiTaO<sub>3</sub>単結晶板、光伝搬媒体材料としてLiNbO<sub>3</sub> 薄膜が使用できることを確認した。

本発明者らは、さらに本発明にかかる構成の光スイッチにおいて、ブラック格子と電極に改良を加えた。すなわち、第3図に示すようにこれらの構成材料として透明導電膜例えば  $I_{n2}O_3$ ,  $S_{n}O_2$  あるいは  $I_{n2}O_3$   $I_{n2}O_3$   $I_{n2}O_3$  などで、光導波路上23に周期性を有する櫛型電極31を設けると、該櫛型電極31がブラック格子を形成するので、ブラック格子と電極が一体化されることを発明した。

この構造を用いると簡型電極間距離を 1 Oum以下に容易に形成できるので消光比を低下させることなく印加電圧がこの構成を用いないものに比べおよそ%の1 O V 以下という低電圧で光スイッチ

を駆動させることができることを確認した。この 構成における透明導電膜は、例えばRFスパッタ とりわけマグネトロン型RFスパッタを用いると、 100℃以下の低温でも容易に形成でき、しかも その光学的特性が良好である。この構成は低温で 形成でき、しかも構造が簡単であるため光ICな どの集積化光デバイスの形成にはより有効である。

以上の説明では、表面被膜として、石英ガラスについて述べたが、表面被膜としては、その光の屈折率が光の伝搬媒体より小さく、またU字標が例えばホトエッチ法で容易に形成できさえすればよく、石英ガラスに限定されるものではない。例えば、棚珪酸ガラス・ソーダガラスの他、窒化シリコン等でも実用できる。

また、前記具体例で示した、基板あるいは光伝 搬媒体の材料以外でも、化学組成やその結晶方位 等を変化させることにより、本発明の光スイッチ の構成材料となりうる。

例えば、II-V族化台物でも本発明の構成の基本 条件さえ満足されていれば使用でき、例えば基板

1 4

にGap を、光伝搬媒体をGaAeにする。この場合、赤外線用の光導波路として有効である。また、I-Vi族化合物も使用可能で、例えば、基板にZnSe単結晶を、光伝搬媒体をZnTeにするとよい。

また、これらの『ーリ族化合物、例えば ZnO, ZnS, CdS, ZnSe, ZnTeあるいはこれらの化合物を光伝搬媒体に用い、基板に α - Aℓ2O3を用いてもよい。例えば、ZnOを光伝搬媒質に用いる場合、(OOO1)面あるいは(O112)面のα-Aℓ2O3単結晶の基板を用い、ZnO膜を例えばマグネトロンスパッタで蒸着すると、スパッタ蒸着中の基板温度が、3OO~4OOCという低温でも、光伝搬損失が例えば 2d B/cm以下という良好な単結晶薄膜がエピタキシャル成長しいた。

また基板に課せられる特性も、必ずしも基板全体に要求されることはなく、基板の表面さえ満足されていればよい。

17

て、第2図に示す構成のものを用いたが、第5図・ 第6図に示す構成の光導波路を用いても、本発明 の効果が得られることを見い出した。

ここで、第 5 図は少なくとも表面に U 字溝 5 1 が設けられた基板 5 2 と、前記 U 字溝 5 1 内に埋役された光伝搬媒体 4 3 とから構成された光導波路を示す。第 6 図は、表面 U 字溝 6 1 が設けられた結晶性基板 6 2 と U 字溝 6 1 の内側面に被覆されたガラス質薄層 6 3 と U 字溝内に埋役された光点 媒体 6 4 とから構成された光導波路を示す。

これらの構造の光導放路を用いれば導波路の境界が明確であり、表面に段差がないので三次元的な構成が可能で第2図に示したものと同様の効果がある。

さらに第7図に示す構成の光回路用基板を本発 明のスイッチに用いても、同様の効果が得られる ことを見出した。

第4図の光回路用基板は少なくとも表面を光伝 搬媒質層で1で獲われた基板で2と、光伝搬媒質層で1と、この光伝搬媒体層で1と基板で2との 本発明者らは、本発明にかかる構成の光スイッチにおいて、電界供給原として太陽電池を用いた。第4図(a),(b)にこの構成を示す。この構成の光スイッチはプラッグ格子25上に光伝搬媒体233の光の屈折率より小さい光の屈折率を有する材料からなるパッファ層41を設け、さらにパッファ層41上に太陽電池42を積層し、この太陽電池42と電優28とを電気的に導電層43を用いて結合させる構造からなる。

この構造の光スイッチを用いると太陽電池に光をONまたはOFFさせることにより光スイッチを駆動させることが可能で、しかも本発明の構造の光スイッチを用いているので消光比が大きく、しかもプラッグ格子25上に太陽電池42を積層しているので外部電源が必要なくかつ不必要な電界が他の部分に加わらないという効果がある。この光スイッチは複雑な電気配線の必要がないので集積化に極めて適しいおり、光のみで制御する光ICを形成することができる。

更に本発明者らは光スイッチ用の光導波路とし

18

間に設けられた基板パッファ層で3とから構成のみた基板パッファ層で3とから構成のみを通過するペく、基板パッファ層で3の光の屈が、光伝搬媒質層で1と接する面にかける。の一個が変をからない。の一個が変をないます。というででである。というででである。というでである。というでもの光スイッチを形成することができる。

以上の説明から明らかなどとく、本発明にかかる光スイッチは、従来の拡散型に見られたような光導波路部の面内での広がりがなく形成でき、またリッジ型のような表面段差が少ないので三合物ならな構成がしやすく、例えばPLZT 系化合物などで構成した光導波路を用いることにより 10 4m 以下で光スイッチを形成することができる。かることにより屈折率の差へ車を低電圧で容易に得ることにより屈折率の差へ車を低電圧で容易に得ることにより屈折率の差へ車を低電圧で容易に得ることにより屈折率の差へ車を低電圧で容易に得ることにより屈折率の差へ車を低電圧で容易に得ることにより配折率の

とができるので、消光比を10dB以上うることができる。また、その光スイッチの加工精度は現在の半導体プロセスを用いれば、1μm 以下の所謂サプミクロンの範囲まで可能である。したがって、本発明にかかる光スイッチは光デバイスの小型化,集積化、光IC等の集積化機能デバイスとして有効である。

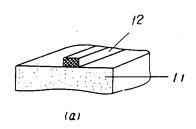
### 4、図面の簡単な説明

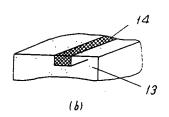
第1図(a),(b)は従来の薄膜光導波路の構造を示す図、第2図は本発明の一実施例にかかる光スイッチの構造を示す図、第3図は本発明の他の実施例にかかる光スイッチの構造を示す図、第4図(a),(b)は本発明のさらに他の実施例にかかる光スイッチの構造を示す図、第6図は光スイッチに用いる光導波路の他の実施例を示す図、第7図は光スイッチに用いる光導波路の他の実施例を示す図である。

22 · ... 基板、23 ...... 光導放路(光伝搬 禁体)、24 ...... 交差部、25 ...... ブラッグ 格子、26 ...... 電圧印加電極、231 ...... 被 膜(保護被膜)、232 ...... 講(U字構)、 233 ...... 光伝搬媒体、41 ...... パッファ層、 42 ...... 太陽電池、43 ...... 導電層。

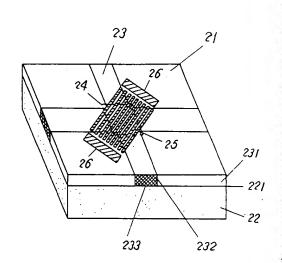
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

易 1 図

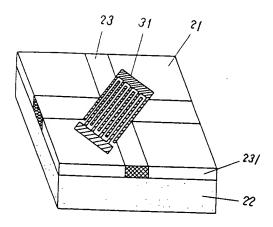


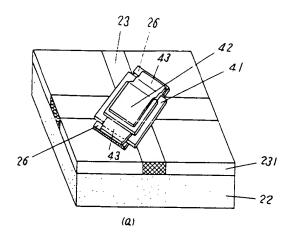


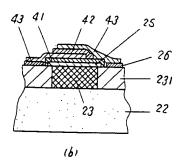




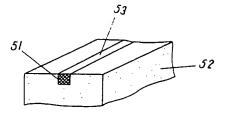




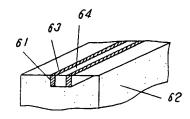




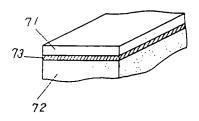
第 5 图



第 6 图



第 7 図





## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57173819 A

(43) Date of publication of application: 26 . 10 . 82

(51) Int. CI

G02F 1/31 // G02B 5/174 G02F 1/03

(21) Application number: 56060195

(22) Date of filing: 20 . 04 . 81

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

KAWAGUCHI TAKAO OCHI KENZO MITSUYU TSUNEO **WASA KIYOTAKA** 

### (54) OPTICAL SWITCH

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent optical switch used for COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio a small-sized device, etc., by covering the surface of a substrate with a protective film, providing grooves meeting at right angles with each other, on the film, in the embedding an optical propagation medium grooves, forming an optical waveguide, and providing a black diffraction grating and one pair of electrodes on said crossing part.

CONSTITUTION: A substrate 22 of a sapphire, etc. is covered with a protective film 231 of SiO<sub>2</sub>, etc., grooves 232 meeting at right angles with each other are formed on the film 231, an optical propagation medium 233 of PbTiO<sub>3</sub>, etc. is embedded in the grooves, and an optical waveguide 23 is formed. On a crossing part 24 of the optical waveguide 23, a black grating 25 for executing the black diffraction is formed by a transparent conductive film. One pair of electrodes 26 are formed in the proximity of the grating 25. In this case, the optical propagation medium 233 whose refractive index is larger than the surface of the film 231 and the substrate 22 is used. Also, as for the refractive index of th grating 25, a material whose refractive index is smaller than the medium 233 is used. In this way, it is possible to easily form an switch which is high in its excellent optical

integration degree and suitable for an optical IC, etc. A comb line electrode can be formed by making it serve as the black grating and the electrode.

